
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請見「業務 — 戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]及其他估計[編纂]開支，並假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即最高[編纂]）後，我們估計將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元。為配合我們的業務戰略及發展，我們擬將[編纂][編纂]按以下金額用於以下用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於提升我們的研發及創新能力。我們視自主研發和創新為核心發展戰略，並計劃保持高水平的研發投入，不斷提升產品性能。特別是：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於保留、擴充及優化我們的研發團隊。半導體行業的特點是技術迭代快及其人才密集性質。為保持競爭力，我們計劃吸引和保留高水平的研發人才，建立一支具有國際視野和強大系統工程能力的優秀團隊。截至2025年9月30日，我們已建立一支由193人組成的研發人才團隊，佔總員工人數的75.1%。為應對智能視覺終端、智能車載、AR/VR和AI & HPC等領域需求的持續增長，我們預計將增聘研發人才，以確保我們的持續創新及競爭力；
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用作提升我們的研發基礎設施。具體而言，該等資金將用作建設我們的中國研發中心以及購置先進設備及工具，包括(i)芯片可靠性測試儀器；(ii)實驗室設備；(iii)計算硬件；及(iv)軟件及知識產權。該等投資旨在提高我們的研發效率、加速產品迭代並加強我們的技術能力；及

未來計劃及[編纂]用途

- (iii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於採購研發消耗品及原材料，包括原型開發及測試所用的印刷線路板及電子元件。該等投資將支持新芯片設計的開發、測試及驗證，確保產品質量及可靠性。
- [編纂]淨額約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於進一步豐富我們的產品矩陣及拓展下游應用場景。特別是：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於提升我們在AI & HPC領域的競爭力並加速這些應用產品種類的商品化。我們的產品路線圖旨在包含更廣泛的高速信號轉換和互連解決方案，以滿足下一代計算系統的嚴苛要求。我們計劃繼續投資於PCIe、SATA及USB等高速協議芯片的研發，以滿足AI訓練、推理及邊緣運算情境中不斷增長的數據吞吐量需求；及
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於擴展我們在新興應用領域的業務，包括智能車載領域及AR/VR領域。我們將繼續在車載娛樂系統、座艙顯示器、HUD、ADAS視頻採集和傳輸SerDes、多工顯示器傳輸SerDes、車用級面板和驅動器、音頻傳輸SerDes以及麥克風和揚聲器等領域拓展汽車級芯片和解決方案。我們亦致力於提升產品效能、整合度及功耗管理，以滿足不斷演進的超低延遲傳輸、超低功耗及微型化需求，並同時推動端側空間計算芯片的研發，以滿足「所見即所得」人機互動的極低運算延遲需求。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於擴大我們的海外業務網絡及提升我們在國際市場的佔有率。特別是，該等資金將用於加強與國際芯片製造商的合作關係、優化全球客戶服務網絡、建立結合國內外代工廠的雙軌道供應體系、

未來計劃及[編纂]用途

擴大國際市場覆蓋，以及提升營銷推廣活動的成效，以支持我們擴展國際業務及鞏固我們在主要海外市場的地位。

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用作在全球半導體行業內進行戰略性投資及收購。我們計劃有選擇性地識別及整合半導體行業的優質資源，以進一步擴展我們的技術及產品組合、加強我們的市場佔有率及渠道能力，以及提升整體行業協同效益及核心競爭力。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂][編纂]淨額低於預期，我們將按比例調整上述目的的[編纂]淨額的分配。

倘我們發展計劃的任何部分因政府政策變化導致我們任何項目發展不可行或發生不可抗力事件等原因而未能按計劃進行，我們將謹慎評估情況並可能重新分配[編纂]的[編纂]淨額。

倘[編纂][編纂]淨額並未即時用於上述用途，在相關法律法規允許的情況下，我們可將未動用的[編纂]淨額存入香港或中國的持牌銀行及／或認可金融機構(定義見證券及期貨條例、《中華人民共和國商業銀行法》及中國其他適用法律)的短期存款。